

第 16 回エレクトロニクス実装学術講演大会プログラム

会期：平成 14 年 3 月 18 日(月)～20 日(水)

会場：神奈川大学横浜キャンパス 7, 8, 10 号館

特別講演

日時：3 月 18 日 13 時～13 時 50 分

会場：同キャンパス 10 号館(4 F) 10-41 教室
「次世代携帯電話の技術動向とパッケージに求められる技術」

講師：BNP パリバ証券 株式調査部・上田弘孝氏

一般講演

3 月 18 日

【A 会場】

「配線板製造技術」

10:00

18A-01 パルス電解を用いたアスペクト比 20 以上ビアの電気銅めっき

上谷 純(沖プリントドサーキット)

10:15

18A-02 電析銅の組織と内部応力に及ぼす添加剤の影響
徳永純一, 都留 豊(九州工大)

10:30

18A-03 光触媒によるビルドアップ用絶縁材料の表面改質とそのめっき法への適用

仲田和貴, 川原 敦, 西脇泰二, 本間英夫(関東学院大)

10:45

18A-04 冷却型連続循環濾過による銅皮膜物性の変化

山本智之, 萩原 謙, 仲田和貴, 本間英夫(関東学院大)

11:00

18A-05 スルーホール, ビアホール混在型基板への電気銅めっき

秋山未来, 三浦修平, 本間英夫(関東学院大)

11:15

18A-06 電解銅箔の表面粗さ形成機構 - (2) Cl⁻の影響

島田久美子, 近藤和夫(岡山大)

11:30

18A-07 微小高さ突起を利用しためっき膜厚の均一化

小寺民恵, 近藤和夫(岡山大)

11:45

18A-08 コバルト電析膜の内部応力形成

津留 豊, 池田智美(九州工大)

14:00

18A-09 依頼講演

微細配線パッケージおよび基板技術の展開

若林信一(新光電気工業)

14:30

18A-10 無電解および電析 NiP めっき膜中のリンの分布状態

田代雄彦, 中里純一, 山本誠二, 本間英夫(関東学院大)

14:45

18A-11 Pd 触媒の代替を目的としたヒドラジン・次亜リン酸系無電解ニッケルめっき

笠原将嘉, 山本誠二, 田代雄彦, 西脇泰二, 本間英夫(関東学院大)

15:15

18A-12 ホルマリンフリー厚付け無電解銅めっき液での

スルーホール接続信頼性向上

板橋武之, 赤星晴夫, 兼元 大, 西村尚樹, 川崎淳一(日立製作所) 飯田 正(日立プリント基板ソリューション)

15:30

18A-13 アルキルホスフィンを錯化剤とするノンシアン無電解金めっき浴

金 東賢, 武内孝夫, 小幡恵吾(大和化成研究所) 縄舟秀美(甲南大)

15:45

18A-14 回路用銅箔のウエットエッチングにおけるレジストパターン形状の影響

鈴木貴晴, 松本克才, 谷口尚司(東北大院)

16:00

18A-15 品質工学による樹脂付き銅箔の成形条件の最適化検討

藤田広明, 田邊貴弘, 熊倉俊寿(日立化成工業)

16:15

18A-16 銅箔付きポリイミド基材からなる一括積層の I/VH 多層配線板

伊藤彰二, 岡本誠裕, 樋口令史, 中尾 知(フジクラ)

16:30

18A-17 COF 用高解像 DFR によるファインパターン形成

高山陽介, 赤尾 伝, 足立輝彦, 森 徹, 外村正一郎(旭化成)

16:45

18A-18 LDI(レーザーダイレクトイメージング)システムによるマスクレス露光のメリット

米田文彦(日本オルボテック)

【B 会場】

「電磁特性技術」

10:00

18B-01 依頼講演

筐体内や伝送線路上に配置した電波吸収材の効果に対する一検討

橋本 修(青山学院大)

10:30

18B-02 依頼講演

携帯電話のアンテナと回路間のシールド設計

深沢 徹, 牧野 滋(三菱電機)

11:00

18B-03 プリントスパイラルスロットアンテナの特性改善の検討

山谷英潤, 越地耕二(東京理科大)

11:15

18B-04 等角スパイラルアンテナアレイの最適化の検討

橋 大輔, 越地耕二(東京理科大)

11:30

18B-05 ミアング配線の不要輻射について

白石信二, 菊池浩一(図研)

11:45

18B-06 ビアを有する多層プリント回路からの電磁放射の検討

夏目康平, 越地耕二, 八木沢 通(東京理科大)
14:00
18B-07 プリント基板内矩形平行平板の共振特性について
椋山英樹(日本 IBM)
14:15
18B-08 多層プリント回路基板の電源グランド系の共振解析
原田高志, 矢口貴宏, 涌井 章, 恵谷誠至, 栗山敏秀,
稲垣慎治(日本電気)
14:30
18B-09 多層プリント板の層構成と不要輻射との関連
芳賀 知, 中野 健(A S E T) 橋本 修(青学大)
14:45
18B-10 伝送線路素子を用いた電源デカップリングの検討
八木沢通, 越地耕二(東京理科大)
15:15
18B-11 コンデンサ特性の二重表記の必要性について
白石信二(図研) 伊藤健一(イトケン研究所)
15:30
18B-12 プリント配線板上の高速信号におけるピア伝送特性に対する一考察
八木貴弘, 小林 剛, 塩坪直利, 高草木秀夫(沖プリンテッドサーキット)
15:45
18B-13 コプレーナ線路分岐点の伝送特性に関する検討
小林俊介, 越地耕二, 中野英樹, 山室守宏(東京理科大)
16:00
18B-14 正弦波を用いた T D R 法による特性インピーダンス測定
荻野智紀, 渋谷 昇, 高橋文博, 作左部剛視(拓大)
16:15
18B-15 コプレーナ型配線の非接触高周波電流測定
島先敏貴, 白鳥悦弘(日本電気インジ アリナ) 安道徳昭, 増田則夫, 玉置尚哉(日本電気)

【C 会場】
「環境調和型実装技術」
10:00
18C-01 IC パッケージのライフサイクルアセスメント
小林 充, 竹ノ内敏一(新光電気工業) 伊坪徳宏(産総研)
10:15
18C-02 P A L U P 基板を用いたプリント基板リサイクルシステム
上村力也, 近藤宏司(デンソー)
10:30
18C-03 SOP リードのはんだ付けにおける鉛フリーはんだ凝固その場観察
芳我基治, 菅沼克昭, 金 榎銖(阪大)
10:45
18C-04 Sn-3.5Ag はんだの接合強度に及ぼす各種鉛フリーはんだめっきの影響と接合界面の微細組織
長尾敏光(関西大院) 藤原 裕, 榎本英彦(大阪市工研) 星加 洋(関西大)
11:00
18C-05 Sn-Zn 系鉛フリーはんだと鉛フリーめっき部品との接合信頼性評価及び組織観察

小松 出, 立石浩史, 小川英紀, 山本展大, 高島幸夫(東芝)
11:15
18C-06 鉛フリーはんだにおけるランド剥離の支配的要因について
田辺一彦(NEC インフロンティア)
11:30
18C-07 鉛フリーはんだ対応はんだこて先チップの損傷低減
竹本 正, 李 明雨, 上谷孝司, 山崎守男(阪大)
11:45
18C-08 エポキシ - 金属系導電性接着剤の熱的・力学的特性
杉村貴弘, 山下宗哲, 中田昌幸, 山口俊郎, 井上雅博, 菅沼克昭(阪大)

「電子部品・実装技術」
14:00
18C-09 電気接点材料に用いられる硬質金めっき膜の特性評価
吉澤賢一, 逢坂哲彌, 本間敬之, 沖中 裕(早大)
14:15
18C-10 はんだ接合強度に及ぼす無電解ニッケル - 置換金めっきプロセスの影響
渡辺秀人(小島化学薬品) 伊澤和彦(野毛電気工業) 山本智之, 本間英夫(関東学院大)
14:30
18C-11 フリップチップ実装に適用する Cu 電極上無電解 Sn めっき皮膜の微視的性質
根本義彦, 富田至洋, 高橋健司(A S E T)
14:45
18C-12 ブラインドピア構造を有するオールフレキシブル多層回路基板
山崎博司, 谷川 聡, 長谷川峰快, 馬場俊和(日東電工)
15:00
18C-13 新規はんだ接続技術を用いた一括積層型オールフレキシブル多層回路基板
中村 圭, 谷川 聡, 馬場俊和, 福岡孝博(日東電工)
15:15
18C-14 ソルダペーストを用いた狭ピッチ対応はんだパンブ形成法
名越俊昌, 嶋田 修, 鈴木和久(日立化成工業)
15:30
18C-15 モンテカルロ法によるはんだ付け不良率の推定
金子公寿, 岸 郁朗, 鴨志田 孝, 下田将義, 松村慶一(富士電機)
15:45
18C-16 Pb フリーはんだと Cu パッドとの界面反応現象の考察
庄司辰也(日立金属) 山本健一, 梶原良一, 守田俊章(日立製作所) 佐藤光司, 伊達正芳(日立金属)
16:00
18C-17 超伝導フリップチップ接続技術と電気的特徴
菊 亮一, 青柳昌宏, 仲川 博, 所 和彦, 菊池克弥(産総研) 川邊 潮(千葉工大)
16:15
18C-18 依頼講演
導電性樹脂ペーストの高周波領域での伝送特性測定と評価

木村 直, 石川治男, 大山千鶴子, 小日向茂(住友金属鉱山)

16:45

18C-19 依頼講演

はんだ代替の導電性接着剤の動向調査報告と提言

武田 修(ティーアンドティー)

3月19日

【A会場】

「信頼性解析技術」

10:15

19A-01 依頼講演

鉛フリーはんだの接続信頼性についての現状と今後の課題

田辺一彦(NEC インフロンティア)

10:45

19A-02 BGA Pbフリーはんだ接合部の耐衝撃強度評価

守田俊章, 梶原良一, 山本健一(日立製作所) 佐藤光司, 伊達正芳, 庄司辰也(日立金属)

11:00

19A-03 BGAはんだ接続部の衝撃曲げ試験方法

矢口昭弘, 山田宗博, 山本健一(日立製作所)

11:15

19A-04 微細はんだ接続部の変形測定に関する基礎検討

中山 昇, 熊沢鉄雄(秋田県立大)

11:30

19A-05 Sn-Zn系はんだボールを用いた接続信頼性評価

伊達正芳, 佐藤光司(日立金属)

11:45

19A-06 Sn-Zn系鉛フリーはんだのフロー接合信頼性

杉浦正洋(ソルダーコート) 田辺一彦(NEC インフロンティア) 寺田博昭(NEC 富山) 武田登志夫(日本電熱計器) 田中 俊(荒川化学工業) 水谷哲治(マルヤ製作所)

13:00

19A-07 ビルドアップ基板の必要熱疲労寿命を満たす最適基板材料の定量的選択方法

近藤 卓, 北城 栄(日本電気) 中村博文(NEC 富山)

13:15

19A-08 プリント配線板の耐湿性評価における加速性試験法の課題

中村和裕(新光電気工業)

13:30

19A-09 鉛フリーはんだのイオンマイグレーションに関する交流インピーダンス法とQCM法を併用した発生予測

平松洋昭, 田中浩和, 植田文崇, 桑川和博, 吉原佐知雄, 白樫高史(宇都宮大院)

13:45

19A-10 鉛フリーはんだのイオンマイグレーション過程に対する系統的解析

田中浩和, 平松洋昭, 桑川和博, 植田文崇, 吉原佐知雄, 白樫高史(宇都宮大院)

「材料技術」

14:00

19A-11 各種金めっき膜のワイヤボンディング性に及ぼす因子について

加藤 勝趙 志宏, 大谷英勝, 沖中 裕, 逢坂哲彌(早大)

14:15

19A-12 Cu電極用ペーストにおけるCu粉形状の影響

坂上貴彦, 山口靖英, 吉丸克彦(彦島製錬)

14:30

19A-13 ガラス上への無電解ニッケルめっきの密着性および平滑化の検討

山本誠二, 杉山拓也, 西脇泰二, 田代雄彦, 本間英夫(関東学院大)

14:45

19A-14 電析法により作製したCo/Pd多層膜の磁気特性

大塚秀幸(神奈川大) 浅 富士夫(上村工業) 小早川絃一, 佐藤祐一(神奈川大)

15:00

19A-15 CO₂レーザーダイレクトドリリングにより良好なVIA形状が得られる銅箔

中野 修, 板垣陽三, 泉谷謙二郎, 中村健介, 片岡 卓, 杉元晶子(三井金属鉱業)

15:15

19A-16 絶縁信頼性改良ガラスクロス基材の開発

木村康之, 松出大祐(旭シェーベル)

15:30

19A-17 耐熱性フォトレジストの新しいコンセプト: 反応現像画像形成(RDP)原理

福島誉史, 大山俊幸, 飯島孝雄, 友井正男(横浜国大院)

15:45

19A-18 薄膜高追従ドライフィルムフォトレジストの開発

小谷雄三, 富田宏朗, 松田英樹, 外村正一郎(旭化成)

16:00

19A-19 無電解Ni/Au部分めっき用感光性フィルム

沢辺 賢, 赤堀聡彦, 青木知明, 梶原卓哉(日立化成工業)

16:15

19A-20 厚膜めっき用高解像ドライフィルムフォトレジスト

前田浩輝, 田沢賢二, 勝又直也(東京応化工業)

16:30

19A-21 レーザー直描用ドライフィルムレジスト

三田高史, 内田廣幸(テフポソMRCDライフィルム)

16:45

19A-22 ドライフィルムの低スラッジ化

小西 亨, 高橋 亨(テフポソMRCDライフィルム)

17:00

19A-23 超高解像度用DFRの密着向上技術

高宮博幸, 日向淳悦, 山本尚俊, 濱田康浩(ニチゴーモートン)

【B会場】

「回路・実装設計技術」

13:00

19B-01 依頼講演

New Methodologies for Signal and Power Integrity Analysis of Electronics Packaging

Jiayuan Fang (Sigrity)

13:30

19B-02 依頼講演

斜め配線のLSI設計へのインパクト

三橋 隆, 五十嵐睦典(東芝)

14:00

19B-03 Libretto L1におけるCPU実装設計技術開発

岩見文宏, 川上 崇, 川村法靖, 高橋邦明, 槇田貞夫(東芝)

14:15

19B-04 自動バッファ挿入機能を持った遅延最小化配線の一手法

植木健史, 築山修治(中大)

14:30

19B-05 Sパラメータを用いた高速伝送波形解析

島崎 睦, 山中康弘, 植松吉晃(三菱電機)

14:45

19B-06 GHz 信号伝送におけるクロストークノイズ

山岸圭太郎(三菱電機)

15:00

19B-07 高速デジタル信号伝送線路の伝播モードにおけるクロストークの考察

上田千寿(イー・イー・ティージャパン) 大塚寛治(明星大) 宇佐美保, 大館康彦(東大)

15:15

19B-08 同軸構造を持つプリント配線基板の開発

佐藤勇一郎, 青柳昌宏, 仲川 博, 所 和彦(産総研) 小林健一, 川俣幸昭, 川島昭彦, 田中直児(神和)

15:30

19B-09 回路網縮小技法に基づく高速回路シミュレータ

久保田英正, 加茂篤司(静岡大) 渡邊貴之(静岡県立大) 浅井秀樹(静岡大)

15:45

19B-10 ポインティングベクトルを用いたプリント基板上のデカップリングコンデンサ位置最適化に関する考察

服部 勲, 加茂篤司(静岡大) 渡邊貴之(静岡県立大) 浅井秀樹(静岡大)

16:00

19B-11 電子素子を導体箱で囲ったプリント配線板グラウンドプレーンからの電磁放射の解析

菊地秀雄(A S E T)

16:15

19B-12 有限要素法と回路解析の連成解析による同時代替ノイズの評価

馬淵雄一, 諏訪元大, 中村 篤, 白井優之, 福本英士, 林 亨, 横溝剛一, 佐藤高史, 大竹成典, 坂田和之(日立製作所)

16:45

19B-13 半導体のピンから見た入力インピーダンス

伊藤健一(イトケン研究所)

17:00

19B-14 不要輻射対策のためのコンデンサメーカーへの要望

伊藤健一(イトケン研究所)

【C会場】

「半導体パッケージ技術」

10:00

19C-01 バンプ, 銅ポスト製造に適した高解像度厚膜DFR

松田英樹, 小谷雄三, 外村正一郎(旭化成)

10:15

19C-02 QFN パッケージ用成形テープの検討

盛島泰正, 石渡伸一(古河電工)

10:30

19C-03 U L S I 配線上へのバリアメタルの形成と評価
石川 薫, 渡邊新吾, 小山田仁子, 三浦修平, 本間英夫(関東学院大)

10:45

19C-04 半導体の前工程における無電解白金めっき

戸田良輔(神奈川大) 大谷 豊, 来田勝継(田中貴金属) 小早川絏一, 佐藤祐一(神奈川大)

11:00

19C-05 電気銅めっきを用いた微細配線形成への添加剤の影響

小山田仁子, 渡邊新吾, 杉本将治, 三浦修平, 香西博明, 本間英夫(関東学院大)

11:15

19C-06 純ニッケルの無電解めっきプロセス及び電解再生システム

中尾誠一郎, 金 東賢, 小幡恵吾(大和化成研究所) 稲澤信二, 真嶋正利, 小山恵司, 谷 佳枝(住友電工)

11:30

19C-07 ポリイミド上の無電解銅めっき皮膜密着性向上

馬場知幸(熊防メタル) 土岐荘太郎, 古屋明彦(凸版印刷) 新宮原正三, 王 増林(広島大) 萩原宗明(くまもとパナ産業財団) 安田敬一郎(緒方工業) 池田秀雄(野田市電子)

11:45

19C-08 バンプウエハ研削用表面保護テープ

鈴木一広(古河電工)

13:00

19C-09 高密度多層配線フィルムを用いた高性能 L S I パッケージ

下戸直典, 本多広一, 菊池 克, 方 慶一郎, 馬場和宏, 松井孝二(日本電気)

13:15

19C-10 高密度多層配線フィルム技術

菊池 克, 下戸直典, 松井孝二, 本多広一, 方 慶一郎, 馬場和宏(日本電気)

13:30

19C-11 W A V E 用 T A B テープの開発

鈴木幸雄, 岡部宏之, 仲沢周一, 大高達也(日立電線)

13:45

19C-12 高周波対応 2 メタル T A B テープの検討

岸野和久大高達也, 石原 剛, 村上英寿(日立電線)

14:00

19C-13 フリップチップ対応 3 メタル T A B テープの開発

杉本 洋, 大高達也(日立電線)

14:15

19C-14 COC 構造における 20 μ m ピッチ微細バンプ接合技術

富田至洋, 梶原良一, 森藤忠洋, 安藤達也, 梅本光雄, 谷田一真, 田中直敬, 高橋健司(A S E T)

14:30

19C-15 フリップチップ実装工程の数値シミュレーション

佐藤武志, 井ノ山達也, 谷藤真一郎, 多田和美(プラメディア)

14:45

19C-16 ウエハレベル CSP の受動部品内蔵化技術

西角紗耶香, 青木由隆, 上 芳夫(電通大)

15:00

19C-17 ファインピッチ実装におけるボール接合性に関する検討

安原和彦, 手島 聡, 板橋一光(田中電子工業)

15:15

19C-18 Cu ダイレクトボンディングに関する検討(第1報)

川田里美(田中電子工業)

15:30

19C-19 Cu ダイレクトボンディングに関する検討(第2報)

川田里美(田中電子工業)

15:45

19C-20 ワイヤ流れにおよぼす封止用樹脂内フィラ粒度分布の影響

大見謝和人(熊本大院)

16:00

19C-21 インタポーザレスBGAの開発

塚野 純, 宮崎崇誌, 前田武彦(日本電気)

16:15

19C-22 SiP(System in Package)の電気特性評価

小澤 要, 合葉和之, 平岡哲也, 小酒井一成, 高島 晃(富士通)

16:45

19C-23 MCPの低熱抵抗化対策

菅田貴司, 佐久本功也, 高島 晃(富士通)

17:00

19C-24 特殊硫酸銅めっきによるピアフィリング

石塚博士, 君塚亮一(荏原ユーザライト)

3月20日

【A会場】

「材料技術」

10:00

20A-01 フリップチップ実装におけるリペア可能封止樹脂の開発

久保雅洋, 杵山一郎, 樺沢俊也, 北城 栄, 松井孝二(日本電気)五十嵐一雅(日東電工)

10:15

20A-02 リペアブルアンダーフィル材(低温速硬化UV系アゾ-フィル材)に関する研究

後藤錠志(ツタ-技研)坪根健一郎, 熊井利夫, 三代絹子(富士通)奥野辰弥(ツタ-技研)

10:30

20A-03 防水メンブレンスイッチ

小野朗伸, 今井隆之, 佐々木信行(フジクラ)黒沢 優(LTEC)

10:45

20A-04 メンブレン式感圧センサ

中嶋敏文, 小野朗伸, 今井隆之, 高橋克彦(フジクラ)伊藤浩二(アイシン精機)

11:00

20A-05 たわみが少ない高性能ガラスエポキシ積層板

片山統夫, 西口賢治, 栗川康宏, 谷澤 郁(利昌工業)

11:15

20A-06 低線膨張性ビルドアップ基板用樹脂の開発

斎藤誠一, 森 貴裕, 高畑義徳, 福田芳弘(旭電化工業)

11:30

20A-07 高実装信頼性CEM-3

平田勲夫(松下電工)

11:45

20A-08 環境調和型高Tgビルドアップ多層プリント配線板材料の開発

小川 桂, 印牧典子, 岩崎智浩(東芝ケミカル)

13:00

20A-09 高密度実装基板用材料

矢吹健太郎, 八月朔日猛, 岡沼雅子, 馬場孝幸, 新井政貴(住友ベークライト)

13:15

20A-10 微細配線形成に適したビルドアップ材料の開発

伊藤 卓, 下大迫寛司, 西中 賢, 村上睦明, 永野広作(鐘淵化学工業)

13:30

20A-11 熱硬化性超薄膜フィルム接着剤

川手恒一郎(住友スリーエム)

13:45

20A-12 ゴアテックスを用いた応力緩和ビルドアップ基板材料の開発

浦上 明, 小川 真(ジャパノアテックス)

14:00

20A-13 弾性率の低い電着ポリイミドの開発

保田慶友, 伊藤信幸, 鈴木雅子, 山田貴子(JSR)

14:15

20A-14 スチレン化合物を用いた高周波用実装材料

天羽 悟, 山田真治, 石川敬郎(日立製作所)

14:30

20A-15 高周波用多孔質ポリイミド配線基板(1)

川島敏行, 田原伸治, 太田 司(日東電工)山田真治(日立製作所)

14:45

20A-16 高周波用多孔質ポリイミド配線基板(2)

山田真治, 石川敬郎(日立製作所)川島敏行(日東電工)

15:00

20A-17 ゴアテックスを使用した低弾性半導体パッケージ用ボンディングシートの開発

大橋和彦, 横溝 資, 吉田浩二(ジャパノアテックス)

15:15

20A-18 高周波材料のハロゲンフリー難燃化に関する検討

末吉隆之, 小川信之, 佐瀬茂雄, 熊倉俊寿(日立化成工業)

15:30

20A-19 高周波対応低誘電率多層板材料

古森清孝, 伊藤直樹, 松下幸生(松下電工)

15:45

20A-20 高周波対応ハロゲンフリー多層材の開発

柏 正道, 飛澤晃彦, 小野塚偉師, 山地貴志, 小宮谷壽郎(住友ベークライト)

【B会場】

「検査技術」

10:00

20B-01 依頼講演

PCBテストへのシステム的アプローチ

梶谷 林, 宗像義臣, 野地 寿, 有我知記(日立レコメテカロジ-)

10:30

20B-02 電子部品検査用メッシュブローブ

花岡裕二, 廣繁勝也, 太田佳秀(NBC)
10:45
20B-03 ICリードコプラナリティ算出方法の比較
大森浩二(アンリツ)
11:00
20B-04 3次元はんだ印刷検査技術
二村伊久雄(CKD)
11:15
20B-05 X線によるフィットレス部品検査技術
寺本篤司, 村越貴行(名古屋電機工業) 堀場勇夫(愛知県立大)
11:30
20B-06 ICパッケージ最終外観検査プロセスと自動検査装置について
木村 泰(日本オルボテック)
11:45
20B-07 光伝送モジュール自動試験設備の開発
内田勝己(日本オブネクスト)

「光回路実装技術」

13:00
20B-08 依頼講演
有機モノリシック光回路の最近の動向
戒能俊邦(東北大)
13:30
20B-09 依頼講演
Optoelectronic Micro System Integration: S-FOLM / SORT / SOLNET
吉村徹三(東京工科大)
14:00
20B-10 光電気複合実装におけるアクティブインタポータ技術
岡部雅寛, 木下雅央, 比留間健之, 石塚 剛, 古山英人, 平松星紀, 三川 孝, 茨木 修(ASET)
14:15
20B-11 光ピンと高分子光線路との挿入結合特性
村田佳一, 鈴木堅史, 宮里健太郎, 水谷 勇, 栗原央典, 三上 修, 内田禎二(東海大)
14:30
20B-12 光インタコネクション用 45°加工ファイバーとVCSELとの光結合
宮里健太郎, 村田佳一, 鈴木堅史, 栗原央典, 水谷 勇(東海大) 市村 顕(ASET) 三上 修(東海大)
14:45
20B-13 はんだボールを用いた光素子の3次元実装技術
安達明直, 小林 誠, 市川 努, 石田 毅, 下村清志(パイオニア)
15:00
20B-14 FTTH用WDM光トランシーバの開発
石川弘樹, 小峰有美子, 西村哲也, 宮下拓也, 松井淳一郎, 石井宏明(日本航空電子工業)

【C会場】

「マイクロメカトロニクス実装技術」

10:00
20C-01 依頼講演
熱毛管型光スイッチ
下川房男(NTT 通信エ研)

10:30
20C-02 MEMS-Adjusted VCSEL-to-fiber Coupling
石川浩嗣(日本発条) Yung Cheng Lee(Univ. Colorado)
10:45
20C-03 圧電薄膜アクチュエータを利用した光スキャニングデバイス
前田龍太郎, 曹 俊杰(産総研)
11:00
20C-04 μ -チャンネルチップをパッケージ化した電子回路デバイスの開発
磯田隆聡, 上江洲一也, 原口 昭, 櫻井和朗, 吉塚和治(北九州市大), 道木啓介(北九州市大分析セ), 山崎得司(北九州産学推進)
11:15
20C-05 依頼講演
自動車用平面ジャイロセンサーの実装法について
相馬隆雄, 石川誠二, 菊池尊之(日本ガイシ)
11:45
20C-06 ウェアラブル機器における生体内通信技術に関する基礎検討
佐々木健, 柴 建次, 中田杏里, 蜂須賀啓介, 武田輝人, 保坂 寛, 板生 清(東大)
13:00
20C-07 依頼講演
ガラスの成形技術
村越 洋, 松村修作(東芝機械)
13:30
20C-08 3次元実装におけるCu電極接合技術
田子雅基, 富田至洋, 春原昌宏, 藤井知徳, 佐藤知稔, 高橋健司(ASET)
13:45
20C-09 真空印刷法によるシリコン基板への導電ペースト充填貫通電極
中村裕成(フジクラ)
14:00
20C-10 リードフレームの微細化に対応した低熱膨張Ni-Fe合金電鍍
永山富男, 水谷 泰, 中村俊博, 篠原長政(京都市工試)
14:15
20C-11 真空中での表面処理による低温ウェハ直接接合
高木秀樹, 前田龍太郎(産総研) 伊藤寿浩, 須賀唯知, オルヤン パリン(東大先端研)
14:30
20C-12 MEMS ブローブカードのためのフリッピンググコンタクトプロセス
伊藤寿浩, 片岡憲一, 須賀唯知(東大先端研)